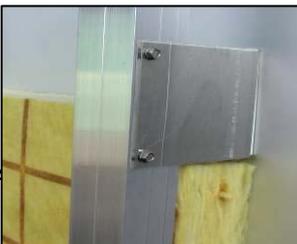


Wagner Système type <<CM2>> Wafer verticale fixation invisible pour panneaux de façade

Connect



Physique du bâtiment

| Groupe systèmes: connect temps moderne | | | | | | |
|--|----------|---------------------|---|--------------|------------------|-----------|
| Sous-construction verticale primaire | | | | | | |
| Classe énergétique [W/(m ² *K)] | | minimal | bon | très bon gut | de premier ordre | |
| | | >0.25 | 0.25-0.20 | 0.20-0.15 | < 0.15 | |
| Système | Matériau | HB à partir de 22 m | Epaisseur d'isolation mm (Lambda 0.032) | | | |
| <<WDK>> Phoenix V | GFK/Alu | | - | 140 | 160 - 200 | 220 - 300 |
| <<PC/PF>> | Alu | ■ | 100 - 140 | 160 - 220 | 240 - 300 | - |
| <<WSZ>> | Alu | ■ | 100 - 140 | 160 - 200 | 220 - 300 | - |
| <<UKS>> | Alu | ■ | 100 - 120 | 140 - 180 | 200 - 300 | - |

Application

| Profils porteurs | | Fixation revêtement | |
|------------------|------------|---------------------|-----------|
| vertical | horizontal | visible | invisible |
| | ■ | ■ | |

(Toutes les données sont indicatives)

Description du système

- **<<CM2>> Wafer** Fixation verticale invisible: la solution pour suspendre des éléments de revêtement préparés industriellement.
- La sous-construction de façade est réalisée avec le système vertical type **<<PC/PF>>** éprouvé.
 - Avancement de console standard de 60 – 300 mm; nous produisons en fonction de l'objet n'importe quel avancement réalisable sur le plan statique.
- Sur la sous-construction verticale du type **<<CM2 Wafer>>**, des fixations de revêtements sont positionnées selon les indications statiques, maintenues en place par une vis d'ajustage et antidérapante.
- Les profilés spécialement découpés sont disposés verticalement sur les plaques de revêtement et peuvent être fixés par **collage** ou **mécaniquement**.
- Le dimensionnement des profilés porteurs de plaques a lieu en fonction des contraintes statiques et de la fixation choisie.
- Après le montage des éléments de revêtement, ceux-ci sont protégés contre le glissement par une sécurité contre la migration et le décrochage.

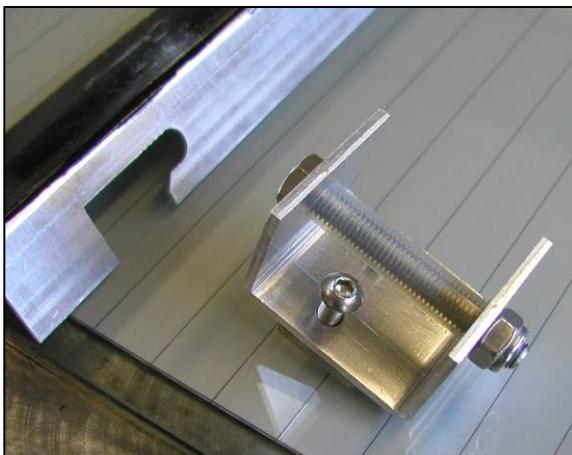
Revêtements

- La construction **<<CM2 Wafer>>** se prête à n'importe quel revêtement.
- Revêtement fixées de manière invisible.

Matériau

- **<<Profilé T Wafer>>** aluminium, épaisseur de 2 mm
- Support de revêtement standard en aluminium; autres possibles spécifiques à l'objet
- Profilés porteurs de plaques

Eléments du système



- Support de revêtement complet
- Profilés porteurs de plaques avec matriçage



- Protection contre la migration